

Слои: 2

Материал: FR4

Готовая толщина: 1.57 мм +√-10%

Наружный слой меди толщиной: 1oz

Отделка: ENIG (Au:2-5u»)

Soldermask (цвет): Обе стороны, LPI (черный)

Шелкография (цвет): Обе стороны, белый

Электрические испытания

ОТДЕЛКА: ЭТОТ СОВЕТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОГРУЖЕНИЕ ПОЗОЛОЧЕННЫЙ СОГЛАСНО IPC-6012.

ТОЛЩИНА должна быть .050uM над 3-6uM никеля.

МЕДНЫЕ ПЛАСТИНЫ ОТВЕРСТИЯ МИНИМУМ.025 AVG,.020 МИН... ОТВЕРСТИЯ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОДКЛЮЧЕН, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ VIAS.500 ГОТОВО ИЛИ МЕНЬШЕ.

Ключ слоя:

=====

*. GM4: Структура Совета

*. TXT: Дрель файл NC

*. GTP: Топ паста

*. GTO: Топ шелкография

*. GTS: Топ Soldermask

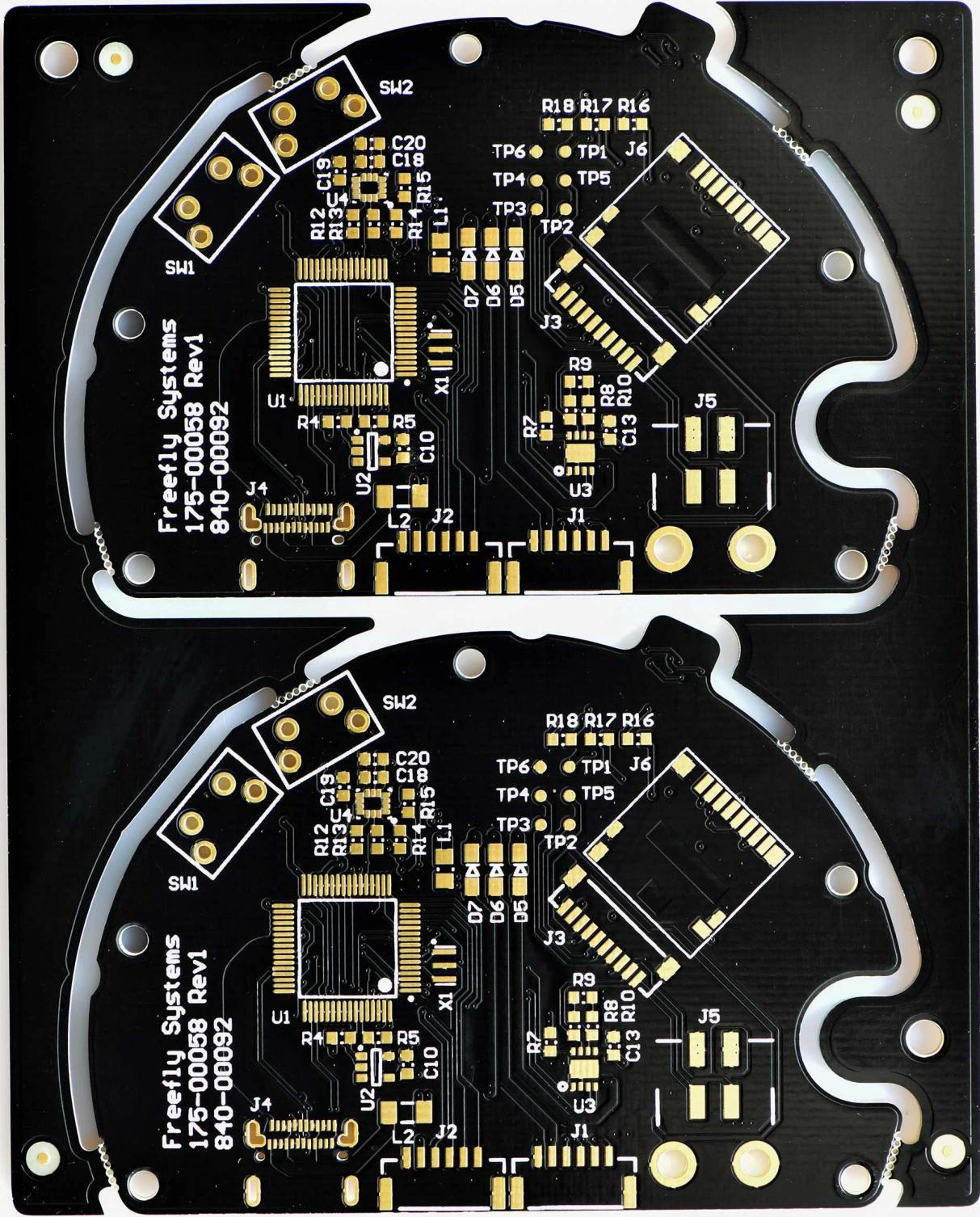
*. GTL: Верхний слой меди

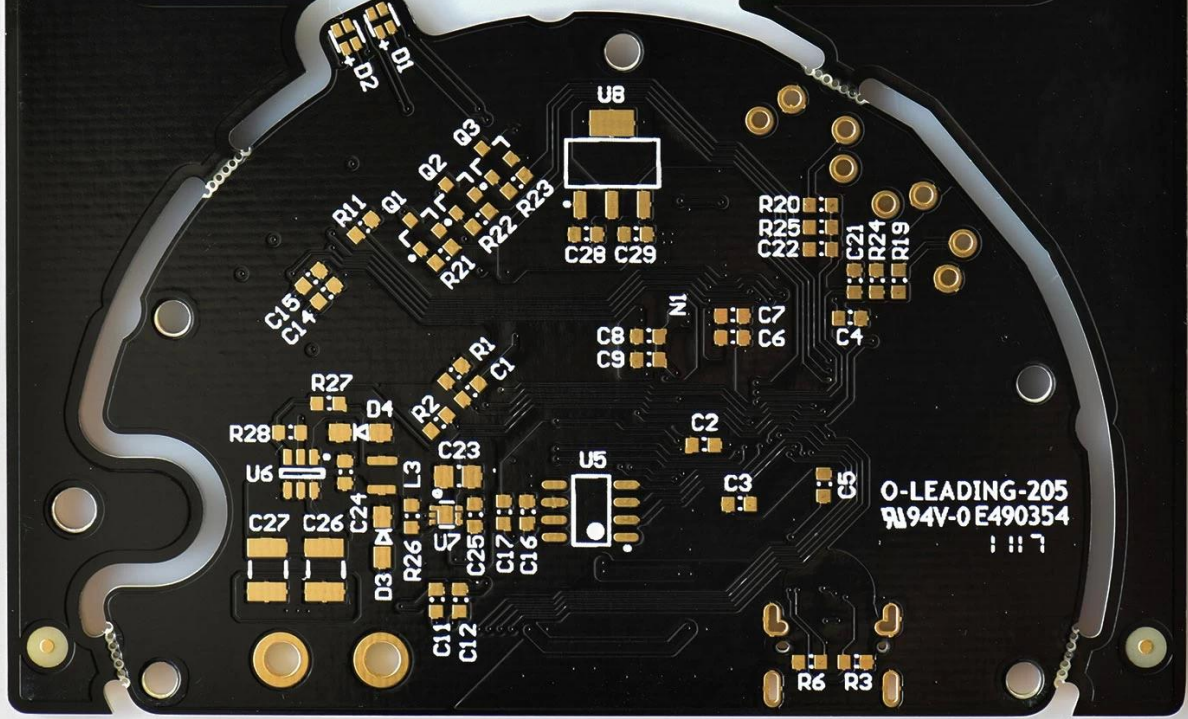
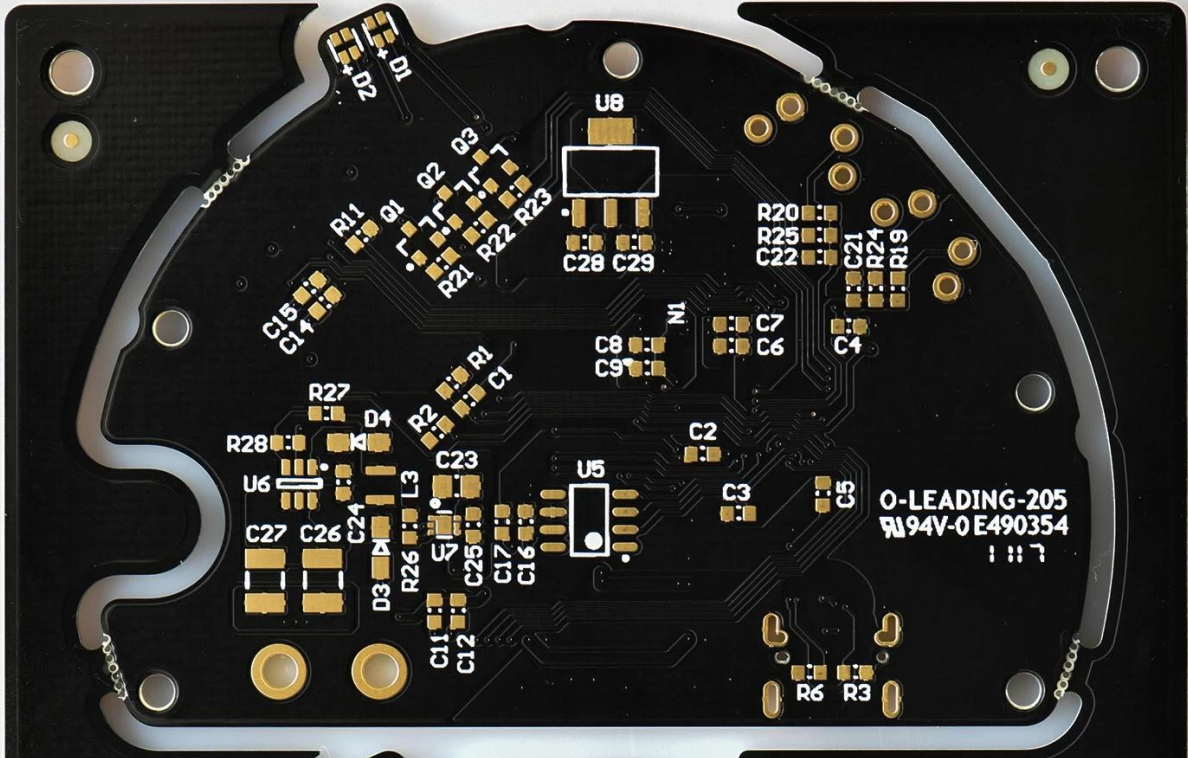
*. GBL: Нижний слой меди

*. GBS: Нижний Soldermask

*. ГБО: Снизу шелкография

*. GBP: Снизу паста





Двухсторонние pcb поставщик, желтый шелкография КСП поставщика